

AIS43X Series-3D

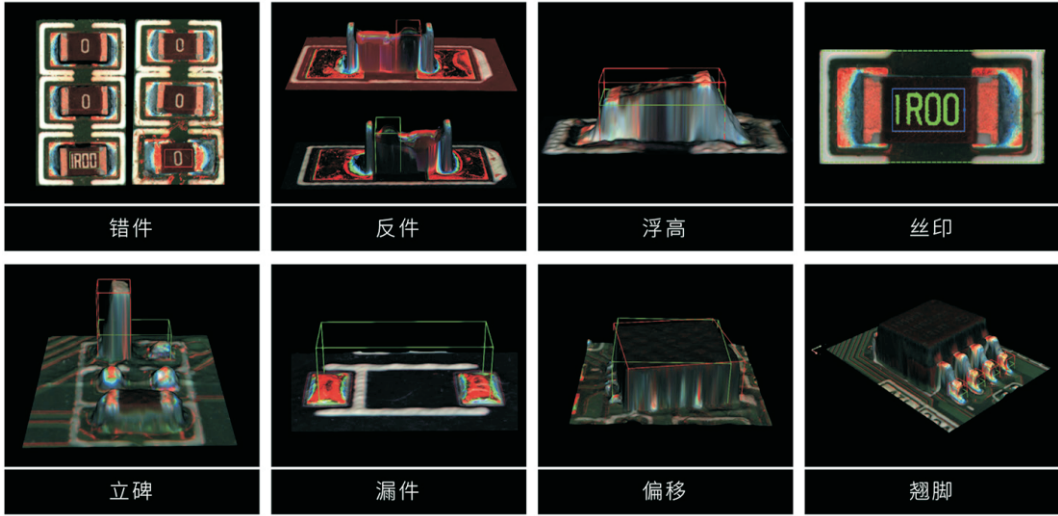


在线PCBA贴片3D光学检测设备
检测贴片元件及焊锡缺陷
3D成像，最小化阴影问题

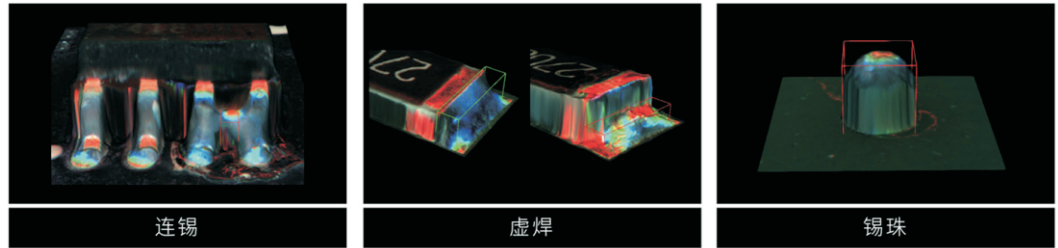
核心优势

- 采用深度图智能去噪，解决3D成像失真问题
- 测量高度范围可配置，适用多种应用要求
- 采用动态自适应基准面技术，自动基板高度校正
- 多频算法增加鲁棒性，降低亮度变化对成像的影响

可检测缺陷实例 | 贴片



可检测缺陷实例 | 焊锡



产品规格

类别	项目	AIS430	AIS430-D
PCBA规格	尺寸	50*50mm~510*460mm (大板模式支持710*460mm)	单轨,50*50mm~510*610mm (大板:710*610mm) 双轨,50*50mm~510*330mm (大板:710*330mm) (中间两轨道间距最小55mm)
	厚度	0.5mm-6mm	
	元件高度	顶面：50mm（标准常规30mm）,底面：50mm（拆掉装饰板可到55mm）	
	轨道高度	900mm	
	板卡负载	3kg	
光学规格	工艺边	3.7mm	
	相机	12MP彩色工业面阵相机	
	光源	RGBW四色积分光源+4方向结构光投影单元	
检测相关	分辨率&FOV	10um@40*30mm, 15um@60*45 mm (标配)	
	元件检测	零件翘起、浮高、缺件、多件、翻转、反向、偏移、破损、歪斜、异物、污损、立碑	
	焊锡检测	爬锡高度、多锡、少锡、拉尖、连锡、空焊、虚焊、锡洞等	
	其他功能	一维/二维码识别/字符识别等	
	混板测试	混板生产、支持程序自动调用	
	算法	深度神经网络算法、颜色对比、轮廓识别、字符对比、高度算法、OCR等	
软件系统	速度	0.55sec/FOV	
	操作系统	Ubuntu 18.04 LTS 64bit	
	功能	远程控制、远程协助、CAD文件导入、自定义模型训练	
	通讯方式	标准SMEMA接口	
	数据输出	自动生成统计分析SPC	
硬件规格	特色功能	元件自动搜索、一键编程	
	工控主机	CPU:intel i7 存储:64G DDR4 , 240G SSD+6T机械硬盘	显卡:RTX3060 12G显存 网络:1000M有线网卡
	显示器	23.8寸 FHD显示器	
	运动机构	高精度丝杆+伺服电机	
	轨道调宽	手动/自动	
外观/电气	机箱尺寸及重量	(L*H*W) 1174*1642*1396mm 净重890KG	(L*H*W) 1174*1642*1671mm 净重1080KG
	电源及功率	AC 220V, 额定功率 510W	AC 220V, 额定功率 540W
	气源	0.4~0.6Mpa	
	工作环境	温度:10~45℃, 湿度: 30~85%RH	